

本期封面



2000年7期

栏目:

DOI:

论文题目: 等温时效对SnAg / Cu表面贴装焊点微结构及剪切强度的影响

作者姓名: 肖克来提 盛玫

工作单位: 中国科学院上海冶金研究所—戴姆勒克莱斯勒联合电子封装研究实验室, 上海
200050

通信作者: 罗乐

通信作者Email: leluo@itsvr.sim.ac.cn

文章摘要: 研究了等温时效对SnAg / Cu表面贴装焊点微结构, Sn-Cu金属间化合物生长及其剪切强度的影响, 并与常用的62Sn36Pb2Ag / Cu焊点进行了比较, 结果表明, 在时效过程中, SnAg钎料以较小的反应速率与Cu发生反应, SnAg焊点显示了较强的剪切强度并且其受时效的影响较SnPbAg焊点要小.

关键词: 表面贴装 等温时效 SnAg / Cu

分类号: TG425.2

关闭